

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

新聞稿

ASMPT宣布SMT解決方案分部之 策略方案評估

題為《ASMPT宣布SMT解決方案分部之策略方案評估》的新聞稿附載於本公告。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二六年一月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)

ASMPT宣布SMT解決方案分部之策略方案評估

(二零二六年一月二十一日，新加坡訊) — ASMPT (香港交易所股份代號: 0522)，一間全球領先之半導體和電子產品製造的集成硬體和軟件解決方案供應商宣布，正就其表面貼裝技術解決方案分部(SMT)啟動策略方案評估。此評估乃ASMPT轉型歷程之一部分，亦體現其持續致力於保障所有持份者（包括員工、客戶及供應商）利益之同時，為股東實現價值最大化。

評估旨在識別最有利於支持SMT長期增長及成功之潛在機遇，同時使ASMPT可聚焦於其日益增長之半導體解決方案分部(SEMI)。

評估將考慮SMT之一系列選項，可能包括但不限於出售、合營、分拆及上市，或保留並支持SMT之戰略發展以確保其長期成功及價值創造。

作為全球市場及技術領導者，SMT結合深度工藝技術、創新科技、行業領先硬件、軟件及服務解決方案。SMT獨特之產品組合為汽車、工業、消費電子及半導體終端市場之電子製造及關鍵應用提供集成解決方案，涵蓋從高混合／低產量至高速量產及先進封裝技術。

SMT之產品組合包括高精度DEK印刷機以及強大的SIPLACE貼片平台，該平台最近獲全新設計之創新SIPLACE V平台輔助。該解決方案組合輔以一整套全面的軟件解決方案，覆蓋從機器及生產線級別至工廠及企業級別。SMT的製造執行系統(MES)為一個模組化、可擴展且支援雲端之平台，能與企業系統及工廠自動化解決方案無縫集成。

摩根士丹利亞洲有限公司就評估擔任本公司獨家財務顧問。

關於ASMPT Limited

ASMPT是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬體及軟件解決方案供應商。ASMPT總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備。ASMPT與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。

ASMPT在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是香港交易所科技100指數、恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港35指數之成份股。詳細資訊請查閱ASMPT網頁www.asmpt.com。

新聞垂詢：

ASMPT全球媒體辦公室

ASMPT Ltd

林詒源(Lim Ee Guan)

企業傳訊總監

電郵: eg.lim@asmpt.com